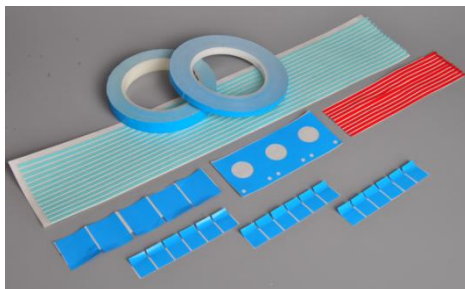


导热双面胶

【产品概述】

SA406FG 导热双面胶, 大量应用于粘接散热片到微处理器和其它的功率消耗半导体上, SA406FG 导热双面胶具有极强的粘合强度, 并且热阻抗小, 可以有效的取代硅脂和机械固定。

【产品图示】



特性参数 SA406FG		
颜色	白色	目视
基材	丙烯酸脂(亚克力)	***
基材加强	玻纤网	***
厚度(mm)	0.15±0.01	ASTM D374
击穿电压(V)	>2500	ASTM D149
剥离力	1.8kg/25mm	PSTC-3
剪切强度 1.0 kg loading on 25 mm x 25 mm	> 48 hrs	PSTC-7
耐热强度 0.5kg loading on 25mm x 25mm at 80°C	> 24 hrs	***
导热系数 (W/mk)	1.0	ASTM D5470
使用温度	-30°C ~ 130°C	***
RoHS	PASS	IEC 62321
Halogen	PASS	EN14582
REACH	PASS	EN14372

使用 ASTM D5470 测试夹具, 记录值包括界面热阻。这些数值仅供参考。实际应用性能直接关系到所施加的表面粗糙度、平整度和压力。

注: 厚度公差为±10%, 硬度公差为±5°, 颜色/厚度/硬度均可按客户需求调试。

【产品用途】

- 1.0W/m-K 导热系数
- 高强粘性适用于各种表面
- 双面压敏粘接胶带
- 高导热亚克力粘胶
- 可承受长期的高温工作环境

【典型应用】

- LED 照明产品
- 底盘、框架或其他散热组件
- 大容量驱动器、热管组件
- RDRAM 记忆存储器
- 高频微处理芯片
- 笔记本和台式电脑

【储存&运输】 贮存于通风、阴凉、干燥处, 不要接触明火。本产品无毒, 按非危险品贮存及运输

【包装】 根据客户需求定制包装

【有效期】 本产品有效期为 12 个月

【安全】 请参阅本公司《材料安全性能数据 (MSDS)》

以上这些建议及数据均来自我们认为可靠的资料。虽然是以诚信提供, 但由于我们无法控制产品的使用条件和方法, 无法对兼容性的应用提出任何建议, 因此这些建议及数据仅供参考, 而不作为产品保证。在任何时候, 应由用户最终决定他们的生产线是否能够有效地使用。应由买方决定产品是否合适或适用特殊用途。不保证产品质量或适用性可满足任何特殊用途。我们建议潜在用户在大量使用前, 首先确定我们的材料适用性和建议。